

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



香港聯交所股票代號：1347

新聞稿

華虹半導體二零二二年第三季度業績公佈

所有貨幣以美元列帳，除非特別指明。

本合併財務報告系依香港財務報告準則編製。

中國香港 — 2022年11月10日 — 全球領先的特色工藝純晶圓代工廠華虹半導體有限公司（香港聯交所股票代號：1347）（「本公司」）於今日公佈截至二零二二年九月三十日止三個月的綜合經營業績。

二零二二年第三季度主要財務指標（未經審核）

- 銷售收入再創歷史新高，達 6.299 億美元，同比上升 39.5%，環比上升 1.5%。
- 毛利率上升至 37.2%，同比上升 10.1 個百分點，環比上升 3.6 個百分點。
- 期內溢利 6,540 萬美元，同比上升 83.7%，環比上升 22.9%。
- 母公司擁有人應佔溢利 1.039 億美元，同比上升 104.5%，環比上升 23.8%。
- 基本每股盈利 0.08 美元，同比上升 105.1%，環比上升 25.0%。
- 淨資產收益率（年化）14.4%，同比上升 6.8 個百分點，環比上升 2.9 個百分點。

二零二二年第四季度指引

- 我們預計銷售收入約 6.30 億美元左右。
- 我們預計毛利率約在 35%至 37%之間。

總裁致辭

公司總裁兼執行董事唐均君先生對二零二二年第三季度業績評論到：

“華虹半導體在二零二二年第三季度業績保持向好。公司各大特色工藝平臺的市場需求持續飽滿，尤其是非易失性存儲器和功率器件。8 英寸晶圓廠和 12 英寸晶圓廠均保持滿載運營，產品平均銷售價格同比環比均有成長。本季度，公司營收為 6.299 億美元，再次刷新歷史紀錄，同比上升 39.5%，環比上升 1.5%；毛利率也創出歷史新高，達到了 37.2%，較去年同期提高 10.1 個百分點，較上一季度高出 3.6 個百分點。”

唐總繼續講道：“公司將繼續瞄準工業應用、汽車電子和新能源等新興市場，立足中國、服務全球，不斷在晶圓代工特色工藝領域開拓創新。並繼續全速推進 12 英寸產能擴充項目，深度融合全球集成電路產業鏈，提高核心競爭力，為客戶提供優質、可靠、高效、多元的全方位產品解決方案。”

電話會議公告

- 日期 2022 年 11 月 10 日 (星期四)
- 時間: 16:00 香港/上海時間
03:00 美國東部時間
- 發言人: 唐均君, 總裁兼執行董事
王鼎, 執行副總裁兼首席財務官
- 廣播: 會議將在 http://www.huahonggrace.com/c/investor_webcast.php 或 <https://edge.media-server.com/mmc/p/o4dr42q8> 作線上直播。
(請提前註冊登記)
- 電話直撥: 請在會議前使用以下鏈接先進行註冊。註冊後, 您將收到確認郵件獲得撥入號碼及個人 PIN。

<https://register.vevent.com/register/BI6aff4c3080d94c4aab32f4e6db1a3c1c>

重要提示: 在會議開始前, 您需要使用確認郵件中提供的個人 PIN 才能進入會議。請在註冊後, 注意查收並保存確認郵件。出於安全原因, 請不要與任何人共享您的 PIN。
- 網上重播: 直播約 12 小時後, 您可於 12 個月內在以下網頁重複收聽會議。

http://www.huahonggrace.com/c/investor_webcast.php

關於華虹半導體

華虹半導體有限公司(「華虹半導體」, 股份代號: 1347.HK) (「本公司」) 是全球領先的特色工藝純晶圓代工企業, 專注於非易失性存儲器、功率器件、模擬及電源管理和邏輯及射頻等「8 英寸 + 12 英寸」特色工藝技術的持續創新, 先進「特色 IC + Power Discrete」強大的工藝技術平台有力支持物聯網等新興領域應用, 其卓越的質量管理體系亦滿足汽車電子芯片生產的嚴苛要求。本公司是華虹集團的一員, 而華虹集團是以集成電路製造為主業, 擁有「8 英寸 + 12 英寸」生產線先進工藝技術的企業集團。

本公司在上海金橋和張江建有三座 8 英寸晶圓廠(華虹一廠、二廠及三廠), 月產能約 18 萬片。同時在無錫高新技術產業開發區內有一座月產能 6.5 萬片的 12 英寸晶圓廠(華虹七廠), 是國內領先的 12 英寸功率器件代工生產線。

如欲取得更多公司相關資料, 請瀏覽: www.huahonggrace.com。

經營業績概要
(以千美元計，每股盈利和營運數據除外)

	二零二二年 第三季度 (未經審核)	二零二一年 第三季度 (未經審核)	二零二二年 第二季度 (未經審核)	同比	環比
銷售收入	629,907	451,484	620,823	39.5 %	1.5 %
銷售成本	(395,851)	(329,231)	(411,953)	20.2 %	(3.9)%
毛利	234,056	122,253	208,870	91.5 %	12.1 %
毛利率	37.2 %	27.1 %	33.6 %	10.1	3.6
經營開支	(73,611)	(72,320)	(70,676)	1.8 %	4.2 %
其他(損失)/收入淨額	(57,825)	7,486	(56,675)	(872.4)%	2.0 %
稅前溢利	102,620	57,419	81,519	78.7 %	25.9 %
所得稅開支	(37,174)	(21,801)	(28,272)	70.5 %	31.5 %
期內溢利	65,446	35,618	53,247	83.7 %	22.9 %
淨利潤率	10.4 %	7.9 %	8.6 %	2.5	1.8
以下各方應佔利潤:					
母公司擁有人	103,899	50,807	83,933	104.5 %	23.8 %
非控股權益	(38,453)	(15,189)	(30,686)	153.2 %	25.3 %
持有人應佔每股盈利					
基本	0.080	0.039	0.064	105.1 %	25.0 %
攤薄	0.079	0.038	0.064	107.9 %	23.4 %
付運晶圓(折合 8 吋仟片)	1,003	907	1,036	10.6 %	(3.2)%
產能利用率 ¹	110.8 %	110.9 %	109.7 %	(0.1)	1.1
淨資產收益率 ²	14.4 %	7.6 %	11.5 %	6.8	2.9

二零二二年第三季度

- 銷售收入再創歷史新高，達 6.299 億美元，同比上升 39.5%，環比上升 1.5%。
- 銷售成本 3.959 億美元，同比上升 20.2%，主要由於晶圓銷售量上升及折舊成本上升，環比下降 3.9%，主要由於晶圓銷售量下降。
- 毛利率上升至 37.2%，同比上升 10.1 個百分點，主要得益於平均銷售價格上漲，部分被折舊成本上升所抵消，環比上升 3.6 個百分點，主要得益於平均銷售價格上漲。
- 經營開支 7,360 萬美元，同比上升 1.8%，環比上升 4.2%。
- 其他損失淨額 5,780 萬美元，上年同期為其他收入淨額 750 萬美元，主要由於外幣匯兌損失增加，環比持平。
- 所得稅開支 3,720 萬美元，同比上升 70.5%，主要由於應課稅利潤增加。
- 期內溢利 6,540 萬美元，同比上升 83.7%，環比上升 22.9%。
- 母公司擁有人應佔溢利 1.039 億美元，同比上升 104.5%，環比上升 23.8%。
- 基本每股盈利 0.08 美元，同比上升 105.1%，環比上升 25.0%。
- 淨資產收益率（年化）14.4%，同比上升 6.8 個百分點，環比上升 2.9 個百分點。

¹產能利用率按平均月約當產量除以總估計月產能計算。

²母公司擁有人應佔利潤 / 加權平均母公司擁有人應佔淨資產。

分部經營業績³
(以千美元計，營運數據除外)

	二零二二年 第三季度 (未經審核)	二零二一年 第三季度 (未經審核)	二零二二年 第二季度 (未經審核)	同比	環比
華虹 8 吋					
銷售收入	384,235	314,784	353,990	22.1 %	8.5 %
毛利	179,340	110,696	156,617	62.0 %	14.5 %
毛利率	46.7 %	35.2 %	44.2 %	11.5	2.5
經營開支	(34,067)	(42,602)	(35,157)	(20.0)%	(3.1)%
稅前溢利	178,940	81,562	141,908	119.4 %	26.1 %
息稅折舊及攤銷前利潤	211,857	118,594	176,457	78.6 %	20.1 %
息稅折舊及攤銷前利潤率	55.1 %	37.7 %	49.8 %	17.4	5.3
付運晶圓(8 吋仟片)	600	622	567	(3.5)%	5.8 %
華虹無錫					
銷售收入	245,672	136,700	266,833	79.7 %	(7.9)%
毛利	54,716	11,557	52,253	373.4 %	4.7 %
毛利率	22.3 %	8.5 %	19.6 %	13.8	2.7
經營開支	(39,544)	(29,718)	(35,519)	33.1 %	11.3 %
稅前溢利	(76,320)	(24,143)	(60,389)	216.1 %	26.4 %
息稅折舊及攤銷前利潤	24,075	29,949	28,614	(19.6)%	(15.9)%
息稅折舊及攤銷前利潤率	9.8 %	21.9 %	10.7 %	(12.1)	(0.9)
付運晶圓(折合 8 吋仟片)	403	285	469	41.4 %	(14.1)%

華虹 8 吋

- 銷售收入 3.842 億美元，同比上升 22.1%，環比上升 8.5%。
- 毛利率 46.7%，同比上升 11.5 個百分點，環比上升 2.5 個百分點，主要得益於平均價格上漲。
- 經營開支 3,410 萬美元，同比下降 20.0%，主要由於人員開支下降，部分被研發活動的政府補助減少所抵消，環比持平。
- 稅前溢利 1.789 億美元，同比上升 119.4%，環比上升 26.1%。

華虹無錫

- 銷售收入 2.457 億美元，同比上升 79.7%，環比下降 7.9%。
- 毛利率 22.3%，同比上升 13.8 個百分點，環比上升 2.7 個百分點，主要得益於平均價格上漲。
- 經營開支 3,950 萬美元，同比上升 33.1%，環比上升 11.3%，主要由於研發開支增加。
- 息稅折舊及攤銷前利潤 2,410 萬美元，同比下降 19.6%，環比下降 15.9%，主要由於外幣匯兌損失增加所致。

³以上各分部的經營業績均為抵消分部間銷售后的數據。

銷售收入分析

按類別劃分的 銷售收入	二零二二年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零二二年 第三季度 % (未經審核)	二零二一年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零二一年 第三季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
晶圓	598,553	95.0 %	431,444	95.6 %	167,109	38.7 %
其他	31,354	5.0 %	20,040	4.4 %	11,314	56.5 %
銷售收入總額	629,907	100.0 %	451,484	100.0 %	178,423	39.5 %

- 本季度 95.0%的銷售收入來源於半導體晶圓的直接銷售。

銷售收入分析

按晶圓尺寸劃分的 銷售收入	二零二二年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零二二年 第三季度 % (未經審核)	二零二一年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零二一年 第三季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
8 吋晶圓	384,235	61.0 %	314,784	69.7 %	69,451	22.1 %
12 吋晶圓	245,672	39.0 %	136,700	30.3 %	108,972	79.7 %
銷售收入總額	629,907	100.0 %	451,484	100.0 %	178,423	39.5 %

- 本季度來自於 8 吋晶圓和 12 吋晶圓的銷售收入分別為 3.842 億美元及 2.457 億美元。

銷售收入分析

按地域劃分的 銷售收入	二零二二年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零二二年 第三季度 % (未經審核)	二零二一年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零二一年 第三季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
中國 ⁴	452,306	71.8 %	331,296	73.4 %	121,010	36.5 %
美國 ⁵	80,450	12.8 %	47,924	10.6 %	32,526	67.9 %
亞洲 ⁶	55,733	8.8 %	44,313	9.8 %	11,420	25.8 %
歐洲	30,340	4.8 %	20,897	4.6 %	9,443	45.2 %
日本 ⁷	11,078	1.8 %	7,054	1.6 %	4,024	57.0 %
銷售收入總額	629,907	100.0 %	451,484	100.0 %	178,423	39.5 %

- 本季度來自於中國的銷售收入 4.523 億美元，占銷售收入總額的 71.8%，同比增長 36.5%，主要得益於 MCU、其他電源管理、智能卡芯片、NOR flash、IGBT 及超級結產品的需求增加。
- 本季度來自於美國的銷售收入 8,050 萬美元，同比增長 67.9%，主要得益於其他電源管理及 MCU 產品的需求增加。
- 本季度來自於亞洲的銷售收入 5,570 萬美元，同比增長 25.8%，主要得益於邏輯及 MCU 產品的需求增加。
- 本季度來自於歐洲的銷售收入 3,030 萬美元，同比增長 45.2%，主要得益於通用 MOSFET、智能卡芯片及 IGBT 產品的需求增加。
- 本季度來自於日本的銷售收入 1,110 萬美元，同比增長 57.0%，主要得益於 MCU 產品的需求增加。

⁴包括中國大陸及中國香港。

⁵包括於 2020 年由一家總部位於歐洲的公司所收購的一家主要美國客戶。

⁶不包括中國及日本。

⁷包括於 2013 年由一家總部位於美國的公司所收購的一家主要日本客戶。

銷售收入分析

按技術平台劃分的 銷售收入	二零二二年	二零二二年	二零二一年	二零二一年	同比	同比
	第三季度	第三季度	第三季度	第三季度		
	仟美元	%	仟美元	%	仟美元	%
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)		
嵌入式非易失性存儲器	213,813	33.9 %	126,514	28.0 %	87,299	69.0 %
獨立式非易失性存儲器	43,473	6.9 %	19,889	4.4 %	23,584	118.6 %
分立器件	191,391	30.4 %	153,080	33.9 %	38,311	25.0 %
邏輯及射頻	59,069	9.4 %	80,079	17.7 %	(21,010)	(26.2)%
模擬與電源管理	121,777	19.3 %	71,110	15.8 %	50,667	71.3 %
其他	384	0.1 %	812	0.2 %	(428)	(52.7)%
銷售收入總額	629,907	100.0 %	451,484	100.0 %	178,423	39.5 %

- 本季度嵌入式非易失性存儲器銷售收入 2.138 億美元，同比增長 69.0%，主要得益於 MCU 及智能卡芯片的需求增加。
- 本季度獨立式非易失性存儲器銷售收入 4,350 萬美元，同比增長 118.6%，主要得益於 NOR flash 產品的需求增加。
- 本季度分立器件銷售收入 1.914 億美元，同比增長 25.0%，主要得益於 IGBT 及超級結產品的需求增加。
- 本季度邏輯及射頻銷售收入 5,910 萬美元，同比下降 26.2%，主要由於 CIS 產品的需求減少。
- 本季度模擬與電源管理銷售收入 1.218 億美元，同比增長 71.3%，主要得益於其他電源管理產品的需求增加。

銷售收入分析

按工藝技術節點劃分的銷售收入	二零二二年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零二二年 第三季度 % (未經審核)	二零二一年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零二一年 第三季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
55nm 及 65nm	78,566	12.5 %	40,109	8.9 %	38,457	95.9 %
90nm 及 95nm	141,726	22.5 %	82,470	18.3 %	59,256	71.9 %
0.11 μ m 及 0.13 μ m	113,063	17.9 %	83,789	18.6 %	29,274	34.9 %
0.15 μ m 及 0.18 μ m	54,590	8.7 %	46,165	10.2 %	8,425	18.2 %
0.25 μ m	3,471	0.6 %	7,040	1.6 %	(3,569)	(50.7)%
0.35 μ m 及以上	238,491	37.8 %	191,911	42.4 %	46,580	24.3 %
銷售收入總額	629,907	100.0 %	451,484	100.0 %	178,423	39.5 %

- 本季度 55nm 及 65nm 工藝技術節點的銷售收入 7,860 萬美元，同比增長 95.9%，主要得益於 NOR flash、邏輯及 MCU 產品的需求增加。
- 本季度 90nm 及 95nm 工藝技術節點的銷售收入 1.417 億美元，同比增長 71.9%，主要得益於其他電源管理、智能卡芯片及 MCU 的需求增加，部分被 CIS 產品需求減少所抵消。
- 本季度 0.11 μ m 及 0.13 μ m 工藝技術節點的銷售收入 1.131 億美元，同比增長 34.9%，主要得益於 MCU 產品的需求增加。
- 本季度 0.15 μ m 及 0.18 μ m 工藝技術節點的銷售收入 5,460 萬美元，同比增長 18.2%，主要得益於 MCU 產品的需求增加。
- 本季度 0.25 μ m 工藝技術節點的銷售收入 350 萬美元，同比下降 50.7%，主要由於 RF 產品的需求減少。
- 本季度 0.35 μ m 及以上工藝技術節點的銷售收入 2.385 億美元，同比增長 24.3%，主要得益於 IGBT、超級結、通用 MOSFET 及其他電源管理產品的需求增加。

銷售收入分析

按終端市場分佈 劃分的銷售收入	二零二二年	二零二二年	二零二一年	二零二一年	同比	同比
	第三季度 仟美元 (未經審核)	第三季度 % (未經審核)	第三季度 仟美元 (未經審核)	第三季度 % (未經審核)	仟美元	%
電子消費品	408,328	64.9 %	280,718	62.2 %	127,610	45.5 %
工業及汽車	148,889	23.6 %	90,176	20.0 %	58,713	65.1 %
通訊	54,138	8.6 %	66,418	14.7 %	(12,280)	(18.5)%
計算機	18,552	2.9 %	14,172	3.1 %	4,380	30.9 %
銷售收入總額	629,907	100.0 %	451,484	100.0 %	178,423	39.5 %

- 本季度電子消費品作為我們的第一大終端市場，貢獻銷售收入 4.083 億美元，占銷售收入總額的 64.9%，同比增長 45.5%，主要得益於各個技術平台產品的需求增加。
- 本季度工業及汽車產品銷售收入 1.489 億美元，同比增長 65.1%，主要得益於 MCU、IGBT、其他電源管理及智能卡芯片的需求增加。
- 本季度通訊產品銷售收入 5,410 萬美元，同比下降 18.5%，主要由於 CIS 產品需求減少，部分被 MCU 及邏輯產品的需求增加所抵消。
- 本季度計算機產品銷售收入 1,860 萬美元，同比增長 30.9%，主要得益於通用 MCU 產品的需求增加。

產能⁸及產能利用率

晶圓廠(仟片晶圓每月)	二零二二年 第三季度 (未經審核)	二零二一年 第三季度 (未經審核)	二零二二年 第二季度 (未經審核)
1 號晶圓廠 (200mm)	65	65	65
2 號晶圓廠 (200mm)	60	60	60
3 號晶圓廠 (200mm)	53	53	53
7 號晶圓廠 (300mm)	65	53	65
合計折合 8 吋產能	324	297	324
產能利用率 (200mm)	113.4%	112.3%	110.0%
產能利用率 (300mm)	107.7%	108.7%	109.3%
總體產能利用率	110.8%	110.9%	109.7%

- 本季度末月產能達 324,000 片 8 吋等值晶圓。總體產能利用率為 110.8%。

⁸ 期末月產能，且為比較目的，以 30 天作為計算基礎。

付運晶圓

折合 8 吋片晶圓	二零二二年 第三季度 (未經審核)	二零二一年 第三季度 (未經審核)	二零二二年 第二季度 (未經審核)	同比	環比
付運晶圓	1,003	907	1,036	10.6 %	(3.2)%

- 本季度付運晶圓 1,003,000 片，同比增加 10.6%，環比減少 3.2%。

經營開支分析

以千美元計	二零二二年 第三季度 (未經審核)	二零二一年 第三季度 (未經審核)	二零二二年 第二季度 (未經審核)	同比	環比
銷售及分銷費用	2,524	2,907	2,530	(13.2)%	(0.2)%
管理費用 ⁹	71,087	69,413	68,146	2.4 %	4.3 %
經營開支	73,611	72,320	70,676	1.8 %	4.2 %

- 經營開支 7,360 萬美元，同比上升 1.8%，環比上升 4.2%。

其他(損失)/收入淨額

以千美元計	二零二二年 第三季度 (未經審核)	二零二一年 第三季度 (未經審核)	二零二二年 第二季度 (未經審核)	同比	環比
租金收入	3,372	3,649	3,852	(7.6)%	(12.5)%
利息收入	7,054	3,411	4,793	106.8 %	47.2 %
匯兌損失	(79,444)	(3,456)	(56,555)	2,198.7 %	40.5 %
分佔聯營公司溢利	2,561	1,393	444	83.8 %	476.8 %
財務費用	(16,886)	(3,175)	(8,194)	431.8 %	106.1 %
政府補貼	24,663	5,542	496	345.0 %	4,872.4 %
其他	855	122	(1,511)	600.8 %	(156.6)%
其他(損失)/收入淨額	(57,825)	7,486	(56,675)	(872.4)%	2.0 %

- 其他損失淨額 5,780 萬美元，上年同期為其他收入淨額 750 萬美元，主要由於外幣匯兌損失增加，環比持平。

⁹管理費用包括確認為研發開支抵減項目的政府補助。

現金流量分析

以千美元計	二零二二年 第三季度 (未經審核)	二零二一年 第三季度 (未經審核)	二零二二年 第二季度 (未經審核)	同比	環比
經營活動所得現金流量淨額	158,604	151,709	212,259	4.5 %	(25.3)%
投資活動所用現金流量淨額	(399,962)	(263,768)	(110,073)	51.6 %	263.4 %
融資活動所得/(用)現金流量淨額	579,684	584,941	(30,087)	(0.9)%	(2,026.7)%
外匯匯率變動影響淨額	(61,748)	(3,057)	(59,383)	1,919.9 %	4.0 %
現金及現金等價物變動影響淨額	276,578	469,825	12,716	(41.1)%	2,075.0 %

- 本季度經營活動所得現金流量淨額 1.586 億美元，同比上升 4.5%，環比下降 25.3%。
- 投資活動所用現金流量淨額 4.000 億美元，其中包括固定資產及無形資產投資支出 4.287 億美元，及投資一家聯營公司 270 萬美元，部分被收到利息收入 1,660 萬美元，政府對設備的補助 900 萬美元，拋售權益工具所得 570 萬美元，及處置設備款項 10 萬美元所抵消。
- 融資活動所得現金流量淨額 5.797 億美元，其中收到控股子公司的非控股權益資本注資 3.920 億美元及提取銀行借款 2.488 億美元，及發行股份收到 300 萬美元，部分被償還銀行貸款本金 6,220 萬美元，支付銀行借款利息 160 萬美元及租賃負債支出 30 萬美元所抵消。

資本結構

以千美元計	於九月三十日 二零二二年 (未經審核)	於六月三十日 二零二二年 (未經審核)
資產總額	6,660,372	6,240,744
負債總額	2,800,784	2,608,878
所有者權益總額	3,859,588	3,631,866
資產負債率 ¹⁰	42.1%	41.8%

資本開支

以千美元計	二零二二年 第三季度 (未經審核)	二零二二年 第二季度 (未經審核)
華虹 8 吋	38,391	17,179
華虹無錫	390,293	95,174
合計	428,684	112,353

- 本季度資本開支 4.287 億美元，其中 3.903 億美元用於華虹無錫。

¹⁰資產負債率=負債總額/資產總額。

流動性分析

以千美元計	於九月三十日 二零二二年 (未經審核)	於六月三十日 二零二二年 (未經審核)
發展中物業	117,971	121,026
存貨	509,630	473,935
貿易應收款項及應收票據	240,551	241,967
預付款項、其他應收款項及其他資產	60,304	63,186
應收關聯方款項	10,764	14,212
已凍結存款及定期存款	1,022	349
現金及現金等價物	1,984,228	1,707,650
流動資產總額	2,924,470	2,622,325
貿易應付款項	223,704	303,263
其他應付款項及暫估費用	621,494	575,171
計息銀行借款	422,913	231,334
租賃負債	4,564	3,309
政府補助	63,274	66,876
應付關聯方款項	10,265	15,630
應付所得稅	57,730	35,532
流動負債總額	1,403,944	1,231,115
淨營運資金	1,520,526	1,391,210
速動比率	1.7x	1.7x
流動比率	2.1x	2.1x
貿易應收款項及應收票據周轉天數	35	35
存貨周轉天數	112	101

- 存貨由上季度末的 4.739 億美元上升至本季度末的 5.096 億美元，主要由於產成品和原材料增加。
- 貿易應付款項由上季度末的 3.033 億美元下降至本季度末的 2.237 億美元，主要由於向供應商付款增加。
- 其他應付款項及暫估費用由上季度末的 5.752 億美元上升至本季度末的 6.215 億美元，主要由於應付資本性開支增加。
- 計息銀行借款由上季度末的 2.313 億美元上升至本季度末的 4.229 億美元，主要由於短期銀行借款增加。
- 應付所得稅由上季度末的 3,550 萬美元上升至本季度末的 5,770 萬美元，主要由於本季度計提所得稅開支所致。
- 淨營運資金 本季度末 15.205 億美元，流動比率 2.1。
- 貿易應收款項及應收票據周轉天數 35 天。
- 存貨周轉天數 112 天。

上述公佈詳情請參閱華虹半導體網站 www.huahonggrace.com。

華虹半導體有限公司
簡明損益表(以千美元計,每股盈利和股數除外)

	截至以下日期止三個月		
	於九月三十日 二零二二年 (未經審核)	於九月三十日 二零二一年 (未經審核)	於六月三十日 二零二二年 (未經審核)
銷售收入	629,907	451,484	620,823
銷售成本	(395,851)	(329,231)	(411,953)
毛利	234,056	122,253	208,870
其他收入及收益	35,967	12,791	9,441
銷售及分銷費用	(2,524)	(2,907)	(2,530)
管理費用	(71,087)	(69,413)	(68,146)
其他費用	(79,467)	(3,523)	(58,366)
財務費用	(16,886)	(3,175)	(8,194)
分佔聯營公司溢利	2,561	1,393	444
稅前溢利	102,620	57,419	81,519
所得稅開支	(37,174)	(21,801)	(28,272)
期內溢利	65,446	35,618	53,247
以下各方應佔利潤			
母公司擁有人	103,899	50,807	83,933
非控股權益	(38,453)	(15,189)	(30,686)
持有人應佔每股盈利			
基本	0.080	0.039	0.064
攤薄	0.079	0.038	0.064
用於計算持有人應佔每股基本盈利的 期內已發行普通股加權平均數	1,303,756,848	1,300,378,175	1,301,760,320
用於計算持有人應佔每股攤薄盈利的 期內已發行普通股加權平均數	1,311,796,050	1,324,812,751	1,316,099,219

華虹半導體有限公司
簡明綜合財務狀況表(以千美元計)

	截至		
	於九月三十日 二零二二年 (未經審核)	於六月三十日 二零二二年 (未經審核)	於九月三十日 二零二一年 (未經審核)
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備	3,140,178	2,955,516	3,026,016
投資物業	165,746	175,337	181,576
使用權資產	78,359	81,994	75,334
無形資產	34,447	31,516	33,640
於聯營公司的投資	116,894	118,129	117,579
以公允價值計量且變動計入其他綜合收益的權益工具	163,182	221,072	250,395
長期預付款項	21,939	24,890	10,429
遞延稅項資產	15,157	9,965	10,824
非流動資產總額	3,735,902	3,618,419	3,705,793
流動資產			
發展中物業	117,971	121,026	107,830
存貨	509,630	473,935	395,788
貿易應收款項及應收票據	240,551	241,967	159,026
預付款項、其他應收款項及其他資產	60,304	63,186	54,463
應收關聯方款項	10,764	14,212	6,987
已凍結存款及定期存款	1,022	349	361
現金及現金等價物	1,984,228	1,707,650	1,444,347
流動資產總額	2,924,470	2,622,325	2,168,802
流動負債			
貿易應付款項	223,704	303,263	159,025
其他應付款項及暫估費用	621,494	575,171	683,763
計息銀行借款	422,913	231,334	181,341
租賃負債	4,564	3,309	1,794
政府補助	63,274	66,876	119,456
應付關聯方款項	10,265	15,630	12,007
應付所得稅	57,730	35,532	34,577
流動負債總額	1,403,944	1,231,115	1,191,963
流動資產淨額	1,520,526	1,391,210	976,839
總資產減流動負債	5,239,501	5,009,629	4,682,632
非流動負債			
計息銀行借款	1,355,037	1,346,974	1,158,994
租賃負債	14,976	15,687	16,131
遞延稅項負債	26,827	15,102	21,867
非流動負債總額	1,396,840	1,377,763	1,196,992
淨資產	3,859,588	3,631,866	3,485,640
權益和負債權益			
股本	1,993,604	1,987,494	1,984,658
儲備	808,552	901,446	704,114
本公司擁有人應佔權益	2,802,156	2,888,940	2,688,772
非控股權益	1,057,432	742,926	796,868
權益總額	3,859,588	3,631,866	3,485,640

華虹半導體有限公司
簡明綜合現金流量表(以千美元計)

	截至以下日期止三個月		
	於九月三十日 二零二二年 (未經審核)	於九月三十日 二零二一年 (未經審核)	於六月三十日 二零二二年 (未經審核)
經營活動所得現金流量：			
稅前溢利	102,620	57,419	81,519
折舊及攤銷	116,426	87,955	115,358
應佔聯營公司溢利	(2,561)	(1,393)	(444)
營運資金的變動及其它	(57,881)	7,728	15,826
經營活動所得現金流量淨額	158,604	151,709	212,259
投資活動所用現金流量：			
購買物業、廠房、設備及無形資產項目	(428,684)	(252,783)	(112,353)
投資聯營公司	(2,704)	(5,921)	-
處置/(投資)權益工具	5,707	(6,290)	-
收到政府對物業、廠房及設備的補助	8,954	-	449
其他投資活動所得現金流量	16,765	1,226	1,831
投資活動所用現金流量淨額	(399,962)	(263,768)	(110,073)
融資活動所得/(用)現金流量：			
非控股權益資本注資	392,000	-	-
提取銀行貸款	248,768	604,986	36,971
發行股份所得收益	2,972	360	393
償還銀行貸款	(62,171)	(19,439)	(54,465)
償還租賃負債	(333)	(710)	(545)
已付利息	(1,552)	(256)	(12,441)
融資活動所得/(用)現金流量淨額	579,684	584,941	(30,087)
現金及現金等價物增加淨額	338,326	472,882	72,099
外匯匯率變動影響淨額	(61,748)	(3,057)	(59,383)
期初現金及現金等價物	1,707,650	974,522	1,694,934
期末現金及現金等價物	1,984,228	1,444,347	1,707,650

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

張素心(董事長)

唐均君(總裁)

非執行董事

孫國棟

王靖

葉峻

獨立非執行董事

張祖同

王桂壩太平紳士

葉龍蜚

承董事會命

華虹半導體有限公司

張素心

董事長兼執行董事

中國 香港

二零二二年十一月十日